

厦门光莆电子股份有限公司
关于调整公司向银行申请综合授信额度
及相关关联担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2016年11月12日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，具体内容为：公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限3年，用途为贷款、承兑商业汇票、出具保函等业务，公司将以位于厦门市翔安区民安大道1802号、1804号、1806号、1808号、1810号的不动产权向中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行提供最高额抵押担保。拟向招商银行股份有限公司厦门分行申请不超过人民币3000万元的综合授信额度，授信期限1年，用途为贷款、票据贴现、商业承兑汇票等业务，该综合授信不涉及抵押、保证等担保（详见公司2016年11月14日披露的《厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-031）、《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告》（公告编号：2016-032）。

在公司向银行申请贷款的过程中，由于受到银行贷款政策的变化等因素的影响，经公司与中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行协商，公司拟将前述总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度调整为 15587.8 万元；经公司与招商银行股份有限公司厦门分行协商，增加由公司子公司厦门光莆显示技术有限公司、厦门爱谱生电子科技有限公司和实际控制人林文坤、林瑞梅为授信额度内贷款提供担保。公司于 2017 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过该事项涉及相关议案（具体内容详见公司于 2017 年 2 月 6 日披露的《厦门光莆电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《厦门光莆电子股份有限公司关于控股股东及子公司为公司贷款提供最高额担保暨关联交易公告》（公告编号：2017-010）。

厦门光莆电子股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 6 日